Влияние конструкции и условий роста метаморфных гетероструктур In(Ga,AI)As/GaAs на электрофизические параметры двумерного канала In_{0.75}Ga_{0.25}As/InAIAs

© М.Ю. Чернов, В.А. Соловьев, И.Л. Дричко, И.Ю. Смирнов, С.В. Иванов

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

E-mail: chernov@beam.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 7 мая 2024 г. В окончательной редакции 12 мая 2024 г. Принята к публикации 13 мая 2024 г.

> Методом молекулярно-пучковой эпитаксии на подложках GaAs получены нелегированные метаморфные структуры с квантовой ямой In_{0.75}Ga_{0.25}As и различной конструкцией барьерных слоев (In,Al)As. Представлены результаты исследований электрофизических параметров таких структур четырехконтактным методом Ван дер Пау и бесконтактным методом, основанным на анализе распространения поверхностных акустических волн вдоль границы раздела пьезоэлектрика LiNbO₃ и образца. Увеличение толщины нижнего барьерного слоя (In,Al)As квантовой ямы, а также оптимизация температуры роста и соотношения потоков элементов V и III групп (As₄/III) позволили получить концентрацию и подвижность носителей в двумерном канале In_{0.75}Ga_{0.25}As толщиной 30 нм $\leq 3.4 \cdot 10^{11}$ см⁻² и $\geq 2 \cdot 10^5$ см²/(B · c) соответственно, при T = 1.7 K.

> Ключевые слова: молекулярно-пучковая эпитаксия, метаморфные гетероструктуры, метаморфный буферный слой, двумерный электронный канал, InGaAs/InAlAs.

DOI: 10.61011/FTP.2024.03.58405.6653

1. Введение

Гетероструктуры InGaAs/InAlAs широко используются в электронике СВЧ-диапазона [1,2]. В частности, НЕМТ-транзисторы на основе гетероструктур In_{0.7}Ga_{0.3}As/In_{0.52}Al_{0.48}As, создаваемые на подложках InP, обладают рекордным быстродействием и минимальными шумовыми характеристиками на сегодняшний день [3,4]. В последнее время особый интерес представляет получение структур с квантовыми ямами (КЯ) $In_xGa_{1-x}As$ (x > 0.7) на подложках GaAs, отличающихся от InP более высокой технологичностью и меньшей стоимостью. При этом возникающая в структурах высокая плотность дислокаций, обусловленная сильным рассогласованием параметров кристаллической решетки подложки GaAs и двумерного канала $In_x Ga_{1-x} As \ (x > 0.7) \ (\Delta a/a > 5\%)$, оказывает негативное влияние на выходные характеристики приборов на их основе. Для решения данной проблемы применяется технология метаморфного роста, суть которой заключается в использовании метаморфного буферного слоя (МБС) твердого раствора переменного состава для создания низкодефектной, свободной от упругих напряжений виртуальной подложки (ВП) [5]. ВП необходима для формирования на ней псевдоморфных слоев, включая двумерный электронный канал. Электрофизические параметры 2D-канала, такие как концентрация и подвижность носителей, сильно зависят от его конструкции и технологических режимов роста. Так, например, было показано, что путем изменения условий молекулярно-пучковой эпитаксии (МПЭ) роста возможно контролировать концентрацию носителей в нелегированных КЯ $In_{0.75}Ga_{0.25}As/In_{0.75}Al_{0.25}As$ толщиной 30 нм от $2 \cdot 10^{11}$ см⁻² до более чем $4 \cdot 10^{11}$ см⁻² [6]. При этом важной задачей является получение высокой подвижности носителей в канале при концентрации, соответствующей заполнению лишь первого уровня размерного квантования во избежание межподзонного рассеяния носителей.

Настоящая работа посвящена исследованию электрофизических характеристик метаморфных структур оригинального дизайна с двумерным электронным каналом In_{0.75}Ga_{0.25}As, получаемых методом МПЭ на подложках GaAs, в зависимости от конструкции барьерных слоев (In,Al)As и условий МПЭ роста (температуры роста и соотношения потоков As₄/III).

2. Эксперимент

Методом МПЭ на нелегированных подложках GaAs(001) с использованием установки RIBER 32P была получена серия метаморфных гетероструктур In(Ga,Al)As (образцы A–E), схематическая конструкция которых приведена на рис. 1. Образцы A, B и C содержали последовательно от подложки буферный слой GaAs (200 нм), метаморфный буферный слой (MБС) $In_x Al_{1-x} As$, состав которого изменялся по корневому закону (1 мкм), виртуальную подложку-нижний барьерный слой, представляющий собой сверхрешетку (СР) 1 нм–InAs/4 нм–In_{0.7}Al_{0.3}As, КЯ In_{0.75}Ga_{0.25}As (30 нм), верхний барьерный слой — СР 1 нм–InAs/4 нм–In_{0.7}Al_{0.3}As (105 нм) и прикрыва-

Образец	Ннижний барьерный слой КЯ In _{0.75} Ga _{0.25} As	Толщина нижнего	Условия МПЭ роста 2D-канала		
	(виртуальная подложка)	барьерного слоя, нм	T_s , °C	As ₄ /III	
А	СР 1 нм–InAs/4 нм–In _{0.7} Al _{0.3} As	40	480	13	
В	СР 1 нм-InAs/4 нм-In _{0.7} Al _{0.3} As	60	480	13	
С	CP 1 нм-InAs/4 нм-In _{0.7} Al _{0.3} As	60	480	10	
D	$In_{0.75}Al_{0.25}As$	120	450	10	
Е	$In_{0.75}Al_{0.25}As$	120	450	8	

Таблица 1. Отличительные особенности конструкции и условий МПЭ роста исследуемых метаморфных гетероструктур (образцов A-E)

Сар	In _{0.75} Ga _{0.25} As	5 nm	
Top barrier	In _{0.75} Al _{0.25} As or SL InAs/In _{0.7} Al _{0.3} As	105 nm	
Channel	In _{0.75} Ga _{0.25} As	30 nm	
Bottom barrier	In _{0.75} Al _{0.25} As or SL InAs/In _{0.7} Al _{0.3} As	40–120 nm	
MBL	$In_x Al_{1-x} As$ $(x = 0.05 - x_{max})$	1 µm	
Buffer	GaAs	200 nm	
	GaAs (001) substrate		

Рис. 1. Схематическая конструкция исследуемых метаморфных гетероструктур In(Ga,Al)As/GaAs с двумерным каналом $In_{0.75}Ga_{0.25}As$.

ющий слой In_{0.75}Ga_{0.25}As (5 нм). Конструкция образцов D и E отличалась от образцов A, B и C типом используемых барьерных слоев. Так, в образцах D и E функцию барьерных слоев выполнял тройной твердый раствор In_{0.75}Al_{0.25}As. MEC In_xAl_{1-x}As, состав которого изменялся по корневому закону $x = x_{\min} + (x_{\max} - x_{\min})(l/l_t)^{1/2}$, где $x_{\min} = 0.05$ и x_{\max} начальное и конечное содержание In в MEC соответственно, а l_t — его толщина, использовался во всех исследуемых в данной работе структурах, так как ранее была продемонстрирована его эффективность в снижении плотности прорастающих дислокаций по сравнению с МБС со ступенчатым или линейным профилем изменения состава [7]. Значение обратной ступени, представляющее собой разницу между конечным составом МБС и составом виртуальной подложки (ВП), выбиралось равным $\Delta x = 0.05$ для образцов A, B, C и 0.06 для образцов D и E. Ранее было показано, что обратная ступень $\Delta x = 0.05 - 0.06$ при использовании МБС с корневым профилем изменения состава позволяет реализовать упругоненапряженную ВП и избежать релаксации упругих механических напряжений в слоях, выращиваемых поверх ВП [8]. Таким образом, конечное содержание In в МБС InAlAs составляло $x_{\text{max}} = 0.75$ в образцах A-C и 0.81 в образцах D и E. Толщина ВП варьировалась в диапазоне 40-120 нм (см. табл. 1). Предполагалось, что использование СР InAs/4 нм-In_{0.7}Al_{0.3}As в качестве ВП позволит снизить плотность прорастающих дислокаций в двумерном канале и тем самым улучшить его электрофизические характеристики.

Рост всех структур, исследуемых в данной работе, начинался с процедуры низкотемпературного ($T_s < 500^{\circ}$ C) отжига подложек GaAs в потоке Ga. Было показано, что при таком отжиге эффективно проходит реакция превращения оксида Ga2O3 в Ga2O, и поверхность становится значительно более планарной, чем при использовании стандартного высокотемпературного отжига, при котором атомы Ga, необходимые для этой реакции, берутся из подложки, создавая в ней ямки [9]. Условия МПЭ роста МБС InAlAs были аналогичны приведенным в работе [10]. Температура роста двумерного канала In_{0.75}Ga_{0.25}As и барьерных слоев (In,Al)As варьировалась в диапазоне $T_s = 450 - 480^\circ \text{C}$ и контролировалась ИК пирометром (IRCON). Калибровка пирометра производилась перед началом роста МБС по изменению реконструкции поверхности GaAs $((2 \times 4)$ As $\rightarrow c(4 \times 4)$ As) с использованием дифракции быстрых отраженных электронов. Данная реконструкция хорошо известна и происходит при $T_s = 500-520^{\circ}$ С в зависимости от давления падающего потока As₄ [11]. Соотношение потоков элементов V и III групп во время роста КЯ $In_{0.75}Ga_{0.25}As$ и барьерных слоев (In,Al)As варьировалось в диапазоне As₄/III = 8 – 13. Скорость роста всех слоев в структурах составляла 0.7 МС/с. МС означает монослой. Отличительные особенности конструкции и условий МПЭ роста образцов A–E приведены в табл. 1.

Для определения электрофизических параметров 2Dканала $In_{0.75}Ga_{0.25}As$, таких как концентрация и подвижность электронов, использовались два метода: 1) четырехконтактный метод Ван дер Пау для измерений при T = 80 и 300 К (для всех образцов) и 2) бесконтактный метод, основанный на анализе распространения поверхностных акустических волн (ПАВ) вдоль границы раздела пьезоэлектрика LiNbO₃ и образца [12], для измерений при T = 1.7 К (для образцов А, С и Е).

Схема акустической экспериментальной установки представлена на рис. 2. Образец прижимается пружиной к поверхности пластины из ниобата лития (LiNbO₃), по обеим сторонам которой сформированы встречноштырьевые преобразователи для генерации и детектирования ПАВ. Затем путем подачи переменного напряжения U_{in} на встречно-штырьевой преобразователь IDT1 за счет пьезоэлектрического эффекта на поверхности LiNbO₃ возбуждается ПАВ. Волна сопровождается переменным электрическим полем, которое проникает в двумерный канал и вызывает токи носителей заряда, изза которых в свою очередь возникают джоулевы потери.

Взаимодействие электрического поля ПАВ с электронами в 2D-канале приводит к изменению амплитуды и сдвигу фазы ПАВ, которые регистрируются вторым встречно-штырьевым преобразователем IDT2. При этом деформация от ПАВ в образец не передается. Акустическая установка помещалась в гелиевый криостат со сверхпроводящим магнитом. Измерения поглощения (Γ) и изменения скорости ПАВ ($\Delta v/v$) проводились на



Рис. 2. Схема акустической экспериментальной установки: вид сверху (верхняя панель) и сбоку (нижняя панель).



Рис. 3. Зависимости поглощения $\Gamma(a)$ и изменения скорости $\Delta v/v$ (b) ПАВ от магнитного поля, полученные для образца А на частоте ПАВ f = 140 MГц. $v = 2E_F/\hbar\omega_c$ — числа заполнения, где E_F —энергия Ферми, $\omega_c = eB/m^*c$ — циклотронная частота.

частоте ПАВ, равной 140 МГц, в поперечном магнитное поле $B \le 8$ Тл. Пример зависимостей $\Gamma(B)$ и $\Delta v/v(B)$, полученных для образца А при T = 1.7 К, представлен на рис. 3. Стрелками на рис. 3 указаны числа заполнения. Аналогичные зависимости были получены для образцов С и Е.

3. Результаты и обсуждение

На рис. 4 представлены зависимости действительной (σ_1) и мнимой (σ_2) частей высокочастотной проводимости $(\sigma^{AC} = \sigma_1 - i\sigma_2)$ от магнитного поля для образцов A (a), C (b) и E (c) при T = 1.7 K, вычисленные по полученным экспериментальным зависимостям $\Gamma(B)$ и $\Delta v/v(B)$ в соответствии с работой [13]. Ранее было установлено, что случай $\sigma_1 < \sigma_2$ соответствует прыжковому типу проводимости, при котором носители локализованы на случайном потенциале примеси/дефектов, в то время как случай $\sigma_1 > \sigma_2$ свидетельствует о проводимости, обусловленной делокализованными носителями [14]. Следует отметить, что на всех зависимостях $\sigma_{1,2}(B)$, полученных для образцов A, C и E при

Образец	Т, К					Условия МПЭ		
	$n, 10^{11} \mathrm{cm}^{-2}$			$\mu, \ \mathrm{cm}^2/(\mathrm{B}\cdot\mathrm{c})$		роста 2D-канал		
	300	80	1.7	300	80	1.7	$T_s, \ ^{\circ}\mathrm{C}$	As ₄ /III
А	8.1	6.7	5.9	11200	73300	210000	480	13
В	7.1	6.5	_	11000	61500	_	480	13
С	6.8	5.6	4.6	11000	64000	190000	480	10

72700

77500

200000

Таблица 2. Концентрация и подвижность электронов в 2D-канале $In_{0.75}Ga_{0.25}As$ метаморфных гетероструктур при T = 1.7, 80и 300 К и параметры роста 2D-канала

9000

9000

T = 1.7 K (рис. 4), действительная часть проводимости (σ_1) превалирует над мнимой (σ_2) при $B \leq 3$ Тл (область полей, в которой наблюдаются осцилляции Шубниковаде Гааза), что позволяет сделать вывод об отсутствии эффектов локализации носителей в двумерном канале и косвенно свидетельствует о высоком кристаллическом совершенстве исследуемых структур. При В > 3 Тл в исследуемых образцах реализуется режим квантового эффекта Холла. По положению минимумов осцилляций Шубникова-де Гааза в магнитном поле (рис. 4) была определена концентрация электронов (n) в 2D-канале образцов А, С и Е при T = 1.7 К (см. табл. 2). Для определения подвижности электронов вычислялась неосциллирующая часть действительной компоненты проводимости (рис. 5) в соответствии с выражениями (1), приведенными в [15]:

4.4

35

4.6

34

9.6

92

D

E

$$\sigma_1(B) = \sigma_1^{1}(B) + \sigma_1^{\text{osc}}(B),$$

$$\sigma_1^{1}(B) = \frac{en\mu c^2}{\mu^2 B^2} \quad (\omega_c \tau = \mu B/c \gg 1), \tag{1}$$

где σ_1^1 и σ_1^{osc} — осциллирующая и неосциллирующая части действительной компоненты высокочастотной проводимости соответственно, *п* — концентрация электронов в КЯ, μ — подвижность электронов при B = 0, e — заряд электрона, ω_c — циклотронная частота, au транспортное время релаксации.

Учитывая то, что $\omega_c \tau \gg 1$, подвижность носителей может быть определена по наклону зависимостей $\sigma_1^{1}(1/B^2)$ (см. вставки на рис. 5). Результаты измерений электрофизических параметров двумерного канала $In_{0.75}Ga_{0.25}As$ методом Ван дер Пау при T = 80 и 300 К (для образцов А-Е), а также бесконтактным акустическим методом при $T = 1.7 \,\mathrm{K}$ (для образцов A, C и E) представлены в табл. 2.

Сопоставляя конструкцию и условия МПЭ роста исследованных в работе структур (см. табл. 1, условия МПЭ роста продублированы для удобства в табл. 2) с их электрофизическими характеристиками (см. табл. 2), можно сделать ряд следующих выводов. Увеличение толщины нижней CP 1 нм-InAs/4 нм-In_{0.7}Al_{0.3}As (в случае образцов А и В) с 40 до 60 нм приводит к незначительному снижению концентрации носителей в двумерном канале $In_{0.75}Ga_{0.25}As$ с $8.1\cdot10^{11}$ до $7.1\cdot10^{11}$ см $^{-2}$ и с $6.7 \cdot 10^{11}$ до $6.5 \cdot 10^{11}$ см⁻² при T = 300 и 80 K соответственно, за счет уменьшения вероятности заброса носителей, локализованных вблизи интерфейса МБС/ВП, в КЯ In_{0.75}Ga_{0.25}As. При этом подвижность носителей при комнатной температуре остается неизменной и равной $\sim 11000 \, {\rm cm}^2/({\rm B}\cdot{\rm c})$. Меньшая подвижность электронов в 2D-канале в образце В по сравнению с образцом А при $T = 80 \,\mathrm{K}$ обусловлена развитием рельефа поверхности в процессе роста СР, вызванным неоптимальными условиями МПЭ ($T_s = 480^{\circ}$ C, As₄/III = 13) и, как следствие, возросшим вкладом рассеяния на шероховатостях интерфейса In_{0.75}Ga_{0.25}As/(In,Al)As. Ранее о снижении подвижности электронов в КЯ In_{0.7}Ga_{0.3}As/In_{0.64}Al_{0.36}As вследствие рассеяния на шероховатости интерфейсов сообщалось в работе [16]. Уменьшение отношения потоков As₄/III с 13 до 10 при неизменных температуре роста $T_s = 480^{\circ}$ С КЯ и конструкции структуры в целом (образец С) позволило получить концентрацию электронов в 2D-канале In_{0.75}Ga_{0.25}As, не превышающую $6.8 \cdot 10^{11}$, $5.6 \cdot 10^{11}$ и $4.6 \cdot 10^{11}$ см⁻² при T = 300, 80 и 1.7 К соответственно, а также увеличить подвижность носителей при T = 80 K до $64\,000 \text{ см}^2/(\text{B} \cdot \text{c})$.

450

450

В нескольких работах [17,18] сообщается, что основным механизмом, снижающим подвижность электронов в нелегированных КЯ InGaAs/InAlAs, является рассеяние на флуктуациях состава твердых растворов. Предполагалось, что в структурах, исследуемых в данной работе, использование СР InAs/In0.7Al0.3As в качестве барьерных слоев для КЯ In_{0.75}Ga_{0.25}As позволит уменьшить вклад данного механизма рассеяния. Тем не менее в образце D, содержащем тройной твердый раствор In_{0.75}Al_{0.25}As в качестве барьерных слоев, были достигнуты значения подвижности электронов при $T = 80 \, {\rm K}$ не ниже, чем в образцах, содержащих СР InAs/In_{0.7}Al_{0.3}As. При этом увеличение толщины нижнего барьерного слоя вдвое (до 120 нм), а также снижение температуры роста барьерных слоев и КЯ до $T_s = 450^{\circ}$ С при соотношении потоков As₄/III, равном 10, позволило получить концентрацию носителей в канале при T = 80 К, не превышающую $4.4 \cdot 10^{11}$ см⁻². Наименьшая концентрация носителей в двумерном канале (3.5 · 10¹¹

10

8

и $3.4 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ при T = 80 и 1.7 K соответственно) была достигнута в образце Е, единственное отличие которого от образца D заключалось в использовании меньшего соотношения потоков As₄/III = 8 во время роста КЯ и барьерных слоев. Кроме того, данный образец





Рис. 4. Зависимости действительной (σ_1) и мнимой (σ_2) частей высокочастотной проводимости от магнитного поля для образцов A (*a*), C (*b*) и E (*c*) при T = 1.7 K и частоте ПАВ f = 140 МГц. Стрелками показаны числа заполнения (ν).

Рис. 5. Зависимости неосциллирующей части проводимости (σ_1^1) от магнитного поля для образцов A (a), C (b) и E (c) при T=1.7 K и частоте ПАВ f=140 МГц. На вставках — зависимости $\sigma_1^1(1/B^2)$, по наклону которых определялась подвижность носителей.

продемонстрировал наибольшую подвижность электронов при $T = 80 \,\mathrm{K}$ среди всех исследуемых структур, равную 77 500 см²/($\mathbf{B} \cdot \mathbf{c}$). Повышенная концентрация электронов при комнатной температуре в двумерном канале образцов D и E по сравнению с образцами A, B и С объясняется отсутствием СР InAs/In_{0.7}Al_{0.3}As, в которой слои InAs локализуют часть электронов. Кроме того, в работе [19] было показано, что слои InAs могут выполнять функцию барьеров для распространения оптических фононов, тем самым снижая электронфононное рассеяние в КЯ, что объясняет меньшую подвижность носителей при комнатной температуре в образцах D и E (9000 см²/($B \cdot c$)) по сравнению с образцами A, B и C $(11\,000\,\text{см}^2/(\text{B}\cdot\text{c}))$. Необходимо отметить, что все структуры, исследуемые в данной работе при $T = 1.7 \,\mathrm{K}$ (образцы A, C и E), характеризуются высокими значениями подвижности носителей в 2D-канале $In_{0.75}Ga_{0.25}As$ (190000–210000 см²/(B · c)), что находится на уровне лучших мировых результатов. Меньшая подвижность носителей при T = 1.7 К в образце С $(190\,000\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{B}\cdot\mathrm{c})$ при $n = 4.6\cdot10^{11}\,\mathrm{cm}^{-2})$ по сравнению с образцами А и Е, вероятнее всего, объясняется вкладом межподзонного рассеяния носителей, который, как было показано в работе [17], максимален при концентрации носителей $n \sim (3.7 - 4.0) \cdot 10^{11} \, \mathrm{cm}^{-2}$

и соответствует заполнению второго энергетического уровня в КЯ.

4. Заключение

Методом МПЭ на подложках GaAs(001) были получены метаморфные гетероструктуры с КЯ In_{0.75}Ga_{0.25}As толщиной 30 нм и различной конструкцией барьерных слоев (In,Al)As. Было установлено, что использование СР InAs/In_{0.7}Al_{0.3}As в качестве барьерных слоев позволяет снизить концентрацию электронов в двумерном канале In_{0.75}Ga_{0.25}As и увеличить их подвижность при комнатной температуре за счет захвата части носителей и оптических фононов слоями InAs. Кроме того, было показано, что увеличение толщины нижнего барьерного слоя с 40 до 120 нм в совокупности с использованием оптимальных режимов МПЭ роста $(T_s = 450^{\circ}\text{C}; \text{As}_4/\text{III} = 8)$ K9 $\text{In}_{0.75}\text{Ga}_{0.25}\text{As}/\text{In}_{0.75}\text{Al}_{0.25}\text{As}$ позволяет получить значения концентрации электронов в 2D-канале $\leq 3.5 \cdot 10^{11} \,\mathrm{cm}^{-2}$ при $T \leq 80 \,\mathrm{K}$, что соответствует заполнению лишь первого уровня размерного квантования, а также подвижность электронов $\geq 77\,500$ и 200 000 см²/($\mathbf{B} \cdot \mathbf{c}$) при T = 80 и 1.7 К соответственно, за счет подавления вкладов межподзонного рассеяния и рассеяния носителей на шероховатостях интерфейсов КЯ. Полученные результаты свидетельствуют о перспективности подобных гетероструктур как для изучения фундаментальных спиновых явлений, так и для создания на их основе с использованием модулированного легирования КЯ структур НЕМТ-транзисторов.

Финансирование работы

М.Ю. Чернов благодарит Российский научный фонд (грант № 22-79-00265) за частичную поддержку данных исследований.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы

- J.Y. Park, B.-G. Min, J.-M. Lee, W. Chang, D.M. Kang, E-S. Jang, J. Kim, J.-G. Kim. Electron. Lett., **59** (14), e12886 (2023).
- [2] J. Ajayan, T. Ravichandran, P. Mohankumar, P. Prajoon, J.C. Pravin, D. Nirmal. IETE J. Res., 67 (3), 366 (2021).
- [3] J. A. del Alamo. Nature, **479**, 317 (2011).
- [4] F. Heinz, F. Thorne, A. Leuther, O. Ambacher. IEEE Trans. Microwave Theory Techniques, **69** (8), 3896 (2021).
- [5] S.V. Ivanov, M.Yu. Chernov, V.A. Solov'ev, P.N. Brunkov, D.D. Firsov, O.S. Komkov. Progr. Cryst. Growth Charact. Mater., 65 (1), 20 (2019).
- [6] F. Capotondi, G. Biasiol, I. Vobornik, L. Sorba, F. Giazotto, A. Cavallini, B. Fraboni. J. Vac. Sci. Technol. B, 22, 702 (2004).
- [7] M.Yu. Chernov, O.S. Komkov, D.D. Firsov, B.Ya. Meltser, A.N. Semenov, Ya.V. Terent'ev, P.N. Brunkov, A.A. Sitnikova, P.S. Kop'ev, S.V. Ivanov, V.A. Solov'ev. J. Cryst. Growth, 477 (1), 97 (2017).
- [8] V.A. Solov'ev, M.Yu. Chernov, M.V. Baidakova, D.A. Kirilenko, M.A. Yagovkina, A.A. Sitnikova, T.A. Komissarova, P.S. Kop'ev, S.V. Ivanov. Superlat. Microstruct., **113**, 777 (2018).
- [9] Y. Asaoka. J. Cryst. Growth, 251, 40 (2003).
- [10] V.A. Solov'ev, M.Yu. Chernov, A.A. Sitnikova, P.N. Brunkov, B.Ya. Meltser, S.V. Ivanov. Semiconductors, 52, 120 (2018).
- [11] Ю.Г. Галицин, Д.В. Дмитриев, В.Г. Мансуров, С.П. Мощенко, А.И. Торопов. Письма ЖЭТФ, 84 (9), 596 (2006).
- [12] I.L. Drichko, I.Yu. Smirnov. Semiconductors, 31, 933 (1997).
- [13] V.D. Kagan. Semiconductors, **31**, 407 (1997).
- [14] I.L. Drichko, A.M. Diakonov, I.Y. Smirnov, Y.M. Galperin, A.I. Toropov. Phys. Rev. B, 62, 7470 (2000).
- [15] T. Ando. J. Phys. Soc. Jpn., 37, 1233 (1974).
- [16] G.B. Galiev, I.S. Vasil'evskii, E.A. Klimov, S.S. Pushkarev, A.N. Klochkov, P.P. Maltsev, M.Yu. Presniakov, I.N. Trunkin, A.L. Vasiliev. J. Cryst. Growth, **392**, 11 (2014).
- [17] F. Capotondi. G. Biasiol, D. Ercolani, L. Sorba. J. Cryst. Growth, 278, 538 (2005).
- [18] S. Gozu, K. Tsuboki, M. Hayashi, C. Hong, S. Yamada. J. Cryst. Growt, 201–202, 749 (1999).
- [19] А. Шиленас, Ю. Пожела, К. Пожела, В. Юцене, И.С. Васильевский, Г.Б. Галиев, С.С. Пушкарев, Е.А. Климов. ФТП, 47 (3), 348 (2013).

Редактор Г.А. Оганесян

Effect of design and growth conditions of metamorphic In(Ga,AI)As/GaAs heterostructures on electrical properties of $In_{0.75}Ga_{0.25}As/InAIAs$ two-dimensional channel

M.Yu. Chernov, V.A. Solov'ev, I.L. Drichko, I.Yu. Smirnov, S.V. Ivanov

loffe Institute, 194021 St. Petersburg, Russia

Abstract Undoped metamorphic structures with In_{0.75}Ga_{0.25}As quantum well and various design of (In,AI)As barriers were grown on GaAs substrates by molecular beam epitaxy. Electrical properties of such structures were studied by using a 4-point Van der Pauw method and contactless technique based on the analysis of propagation of surface acoustic waves along the interface of the piezoelectric LiNbO₃ and the sample. Increasing the thickness of the bottom barrier layer of the In_{0.75}Ga_{0.25}As quantum well as well as optimizing the growth temperature and As₄/III ratio allowed achieving concentration and mobility of 2D carriers in 30 nm-thick In_{0.75}Ga_{0.25}As QW of below $3.4 \cdot 10^{11}$ cm⁻² and above $2 \cdot 10^5$ cm²/(V · s), respectively, at T = 1.7 K.